

參考資料

1. 楊宜豐，防彈衣回收 Kevlar 纖維濕式抄造紙張之研究(2003)
2. 李祺菁，經濟部技術處產業技術服務計畫，
2005 年我國 PCB 產值成長 10%
3. 陳聿鈞，克維拉纖維與鐵氟龍纖維製備製造電子用基層版之研究
(2005)。
4. 曾峰柏，高耐熱機板技術，工業材料雜誌 10 月號(2006)。
5. PCB 原理
<http://www2.nsysu.edu.tw/IEE/lou/elec/web/process/pcb.htm>
6. L. S. penn and Flarsen, J Appl Polym. Sci, 23(1979)59
7. 陳平、蔡金剛，芳綸纖維及其織物複合材料在電子電器領域中的應
用，纖維複合材料，P. 48(1994)
8. DuPont. Magazine, Chinese Edition 2003-NO. 4
9. 蕭弘毅、楊正昌、林金雀，機能紙簡介，化工資訊，P. 9~P. 23 ，
Vol. 9, No. 4 (1995)
10. William D. Callister 著，游信和、曾春風、陳文照譯，材料科
學與工程導論，高立圖書有限公司。
11. H. H. Yang, Kevlar Aramid Fiber, Jonh Wiley&Sons(1992)

12. 2003 DU PONT — TORAY CO., LTD. ,
<http://www.td-net.co.jp/kevlar/technology.html>
13. 趙珏、吳文隆，對位芳香聚醯胺(Para-aramid)的性質、裁切加工
及應用-2-，強化塑膠 Vol. 89, P. 52~P. 64(2001)
14. 武剛，複合材料在工程中的應用
15. 正儀實業股份有限公司~BT 樹脂製成與運用
16. 時報閱讀網，<http://www.readingtimes.com.tw/index.htm>
17. 化工產業技術知識網，<http://www.chemtech.com.tw>，
四氟乙烯簡介
18. 黃俊雄，ePTFE 電漿改質膜之剝離強度研究，中原大學化學工程
研究所碩士論文，(2001)
19. 電路板機械加工技術，台灣電路板協會出版
20. 曾峰柏，綠色環保材料~高耐熱無鹵銅箔基板材料技術發展趨勢
(一)，工業材料雜誌 9 月號 P. 116~P. 123(2007)
21. 陳碧義，印刷電路板用填充材料處理技術介紹(上)，工業材料雜
誌 9 月號，P. 124~P. 126(2007)
22. 陳碧義，印刷電路板用填充材料處理技術介紹(下)，工業材料雜
誌 10 月號，P. 174~P. 180(2007)
23. 紙的技術協誌 11994 年五月刊 Japan Tappi Journal(P36~P37)